



台積公司董事會決議

發佈單位：台灣積體電路製造股份有限公司

發佈日期：2020年11月10日

台灣積體電路製造股份有限公司今（10）日召開董事會，重要決議如下：

- 一、核准配發 2020 年第三季之每股現金股利 2.5 元，其普通股配息基準日訂定為 2021 年 3 月 23 日，除息交易日則為 2021 年 3 月 17 日，依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自 2021 年 3 月 19 日起至 3 月 23 日止，停止普通股股票過戶，並於 2021 年 4 月 15 日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日亦為 2021 年 3 月 17 日，與普通股一致。台積公司美國存託憑證之配息基準日訂為 2021 年 3 月 18 日。
- 二、核准資本預算約美金 151 億 910 萬元（約新台幣 4,306 億 934 萬元），內容包括：1. 建置及擴充先進製程產能；2. 建置特殊製程產能；3. 建置及升級先進封裝產能；4. 廠房興建、廠務設施工程及資本化租賃資產；5. 2021 年第一季研發資本預算與經常性資本預算。
- 三、核准資本預算約美金 1 億 2,470 萬元（新台幣 35 億 5,500 萬元），於中部科學園區建置零廢製造中心。
- 四、核准於美國亞利桑那州設立一百分之百持股之子公司，實收資本額為美金 35 億元（約新台幣 997 億 5,000 萬元）。
- 五、核准以下人事擢升案：
 1. 擢升本公司歐亞業務組織資深處長游秋山博士為副總經理。
 2. 擢升本公司品質暨可靠性組織資深處長何軍博士為副總經理。

關於台積公司

台積公司成立於 1987 年，率先開創了專業積體電路製造服務之商業模式，自此成為全球規模最大的專業積體電路製造服務公司。台積公司以領先業界的製程技術及設計解決方案組合支援其客戶及夥伴生態系統的蓬勃發展，以此釋放全球半導體產業的創新。身為全球的企業公民，台積公司的營運範圍遍及亞洲、歐洲及北美，致力成為企業社會責任的行動者。

2019 年，台積公司提供最廣泛的先進製程、特殊製程及先進封裝等 272 種製程技術，為 499 個客戶生產 1 萬 761 種不同產品。台積公司為世界首家提供 5 奈米製程技術，即現今最先進的製程技術為客戶生產晶片的專業積體電路製造服務公司。其企業總部位於台灣新竹。進一步資訊請至台積公司網站 <https://www.tsmc.com.tw> 查詢。

#

台積公司發言人：

黃仁昭
副總經理暨財務長
Tel: 03-505-5901

台積公司新聞連絡人：

高孟華
企業公共關係部主管
Tel: 03-563-6688 ext. 712 5036
Mobile: 0988-239-163
E-Mail: nina_kao@tsmc.com

李國維
企業公共關係部
Tel: 03-563-6688 ext. 712 5037
Mobile: 0988-932-757
E-Mail: baker_li@tsmc.com